

Best consulting

全球半导体行业周报

存储利润创纪录而股价回落，晶圆代工产能争夺转向长约与融资

发布主体：百思特变革研究院半导体智库 | 期次日期：2026-10-12 | 覆盖窗口：2026-10-05 至 2026-10-11

本期总判断

本周存储企业交出创纪录的利润，资本市场却以下跌回应；先进制程产能的争夺从订单竞争转向长约锁定与债务融资，规则层面连续第三周没有新的管制文本。

一、存储利润达到历史高点，市场开始定价增速放缓。三星电子三季度初步营业利润 107.4 万亿韩元、同比增长 782.5%；Micron 第四财季营收 542.3 亿美元、非 GAAP 毛利率 87.0%，第一财季指引中值 615 亿美元。同周 SK 海力士跌 8.69%、铠侠跌 9.30%、SanDisk 跌 8.03%、Micron 跌 4.27%，四季度常规 DRAM 合约价预测涨幅 10%—15%，低于三季度。

二、台积电三季度营收超出指引上限。7—9 月合计 14,942.4 亿新台币、同比增长 50.9%，按公司 32 的汇率假设折约 467 亿美元，高于 446 亿—458 亿美元指引上限约 2%；9 月单月 5,118.6 亿新台币、环比下降 0.6%。AMD 首席执行官 10 月 6 日访台，公司表示产能规划已提前 3 至 5 年锁定。

三、Terafab 合作方之争压低 Intel。马斯克 10 月 3 日确认与台积电"只是讨论"，Intel 周跌 12.26%、Arm 周跌 13.40%，为本周美股半导体跌幅最大的两只；Intel 首席执行官 10 月 7 日称公司仍是 Terafab 开发伙伴。

四、先进封装之外，测试成为新的产能约束。测试厂矽格表示客户已签订一年以上产能协议并接受涨价，2026 年资本开支增至 88 亿新台币、同比增长 48%；野村估计 Rubin 平台最终测试时间约为 Hopper 的 7 倍，测试成本占 GPU 制造成本由 1.9% 升至 3.3%。

五、出口数据继续放大。韩国 9 月半导体出口 603 亿美元、同比增长 263%，占总出口 49.9%；台湾 9 月出口 872.2 亿美元、同比增长 60.9%；SIA 8 月全球销售 1,597 亿美元、同比增长 144.3%，1—8 月累计突破 1 万亿美元。

资本市场：费城半导体指数周跌 4.30% 至 12,572.4，距 6 月 22 日峰值回撤 14.1%；同期标普 500 ETF 涨 1.16%。A 股节后两个交易日科创 50 累计下跌 4.75%。

宏观约束：美债 10 年期收益率 10 月 9 日为 5.24%，较一个月前的约 4.75% 抬升约半个百分点；布伦特原油 10 月 1 日重回 100 美元上方，数据中心建设的资金与能源成本同步上升。

需要跟踪的关键变量：10 月 15 日台积电三季度财报与四季度指引、SEMICON West 设备企业对 2027 年的资本开支口径、10 月 29 日三星完整财报中的存储分部利润率、11 月上旬两项贸易限制措施暂停期到期后的安排。

目录

本周概览..... 3

一、 本周要点.....6

二、 重大事件及其影响..... 6

三、 行业景气与资本市场..... 7

四、 存储周期与装备制造链..... 9

五、 政策、贸易与供应链安全..... 9

六、 重点企业动态..... 10

七、 中国半导体产业链..... 11

八、 行业会议与人物观点..... 12

九、 趋势判断..... 12

十、 主要风险与下周关注事项..... 13

十一、 管理观察与行动建议..... 14

数据来源与口径..... 14

阅读导引：企业决策层建议优先阅读"本周要点""重大事件及其影响""趋势判断"与"管理观察与行动建议"; 制造、存储与设备企业建议重点阅读"存储周期与装备制造链""重点企业动态"; 政策与资本市场研究人员建议重点阅读"行业景气与资本市场""政策、贸易与供应链安全"与"主要风险与下周关注事项"。

本周概览

关键指标

全球半导体月销售额（8月，SIA） 1,597 亿美元 同比 +144.3%，环比 +8.0% 三个月移动平均；1—8月累计突破1万亿美元	日本制半导体设备销售额（8月） 5,979 亿日元 同比 +47.4% 最新已发布月份；9月数据预计10月下旬发布	韩国半导体出口（9月） 603 亿美元 同比 +263% 占总出口 49.9%，总出口 1,209 亿美元创纪录
费城半导体指数（10月9日） 12,572.4 周 -4.30% 距6月22日峰值-14.1%，年内约+77.5%	科创50指数（10月9日） 1,457.27 -4.75%（节后两日） 10月8日复市单日-4.82%	DDR5 16Gb 现货价（10月9日） 58.900 美元 较9月21日+3.5% DDR4 16Gb 报 83.640 美元，倒挂收窄
三星电子三季度初步营业利润 107.4 万亿韩元 同比 +782.5% 营收 195 万亿韩元，同比 +126.6%	台积电三季度营收 14,942.4 亿新台币 同比 +50.9%，环比 +17.6% 折约 467 亿美元，高于指引上限约 2%	美债 10 年期收益率（10月9日） 5.24% 周 -4 个基点 10月2日为 5.28%

一周大事记（2026 年 10 月 5 日至 10 月 11 日）

10月5日 周一	■ SIA 公布 8 月全球半导体销售额 1,597 亿美元，环比增长 8%、同比增长 144.3%，美洲同比 +180.9%、中国 +131.3%、欧洲 +98.5%、日本 +62.3%，1—8 月累计突破 1 万亿美元 ■ 马斯克 10 月 3 日在社交媒体确认 Terafab 与台积电"只是讨论"，Intel 盘前下跌 4.2%，盘中由开盘 124.01 美元跌至 114.33 美元 ■ 鸿海 9 月营收 1.159 万亿新台币，首次单月突破 1 万亿，同比增长 38.42%，三季度 3.03 万亿新台币、同比增长 47.12% ■ TrendForce 汇总台积电财报前瞻，2026 年资本开支指引区间 600 亿—640 亿美元，亚利桑那计划总投资 2,650 亿美元 ■ 512Gb TLC NAND 晶圆现货周跌 2.90% 至 18.833 美元
10月6日 周二	■ AMD 首席执行官苏姿丰访问台积电及供应链伙伴，AMD 表示产能规划已提前 3 至 5 年，MI450 采用台积电 2nm 与 CoWoS、三季度进入台积电生产，MI455 于 2027 年上半年投产 ■ JEDEC 发布 JESD264，为首个硅光可靠性行业标准 ■ 南亚科三季度营收 1,336.5 亿新台币、环比增长 61.9%，9 月营收同比增长 576.62%，预计四季度 DRAM 平均售价上涨约 10%、仅能满足客户 50%—60% 需求 ■ 华邦电三季度营收 823.3 亿新台币、环比增长 37.58% ■ DDR4 1Gx8 3200 现货均价 46.32 美元，与前一周持平 ■ SEMI 加入欧盟半导体人才工作小组

10月7日 周三	■ Intel 首席执行官陈立武表示公司仍是 Terafab 开发伙伴 ■ 华为徐直军称昇腾在中国市场份额可能已超过 NVIDIA，昇腾 950DT 超节点预计 2026 年底至 2027 年初放量，Hi-ONE 近封装光学模块 7.2T、称成本较共封装光学低近 40% ■ 据报道 Micron 2027 财年上半年资本开支约 250 亿美元，2027 年大部分 HBM 供应已签约且价格高于 2026 年 ■ LG 电子三季度初步营业利润 7,818 亿韩元、同比增长 13.5% ■ 粤芯半导体公告发行结果，网上有效申购倍数 2,359.68 倍、中签率 0.0424%
10月8日 周四	■ 三星电子公布三季度初步业绩，营业利润 107.4 万亿韩元、同比增长 782.5%，营收 195 万亿韩元、同比增长 126.6%，HBM4 开始向 NVIDIA Vera Rubin 实质供货 ■ 台积电 9 月营收 5,118.6 亿新台币、环比 -0.6%、同比 +54.6%，三季度合计 14,942.4 亿新台币 ■ 台湾 9 月出口 872.2 亿美元、同比增长 60.9%，连续第 35 个月增长，电子零组件 311.3 亿美元、同比增长 45.3% ■ TrendForce 预计 2027 年全球笔记本电脑出货低个位数下滑，VCSEL 需求 2031 年达 6.5 亿颗 ■ 测试厂矽格表示客户签订一年以上产能协议，2026 年资本开支增至 88 亿新台币 ■ A 股节后复市，科创 50 下跌 4.82%，创业板指下跌 3.15%，成交 1.69 万亿元
10月9日 周五	■ TrendForce 报道 NVIDIA NVHBM 方案将内存控制器移入 HBM 基础裸片，带宽较标准 HBM4E 最高提升 30%、功耗最高降低 15%，Micron HBM4E 基础裸片转由外部晶圆厂制造 ■ 美国一项 DRAM 器件专利纠纷因当事方和解终结 ■ Ultra Clean Technology 获准在得州 Manor 自贸区开展生产 ■ 费城半导体指数收于 12,572.4，周跌 4.30% ■ A 股深 V 收红，科创 50 收 1,457.27、上涨 0.07%，成交约 1.9 万亿元，半导体板块下跌 0.68%、主力净流出 41.86 亿元 ■ 韩国、台湾股市休市
10月10日 周六	■ 豪威集团港股跌破 104.80 港元发行价，A 股收 79.15 元，低于 138.57 元的股权激励行权价 ■ 台湾方面预计 10 月出口 852 亿—877 亿美元、同比增长 40%—44%
10月11日 周日	■ 成都双流首批国产微米级接近式光刻机订单突破 1 亿元（据新浪财经报道），面向光芯片、显示与 LED，11 月初集中发货 ■ 粤芯半导体确定 10 月 13 日在创业板上市

一周图表

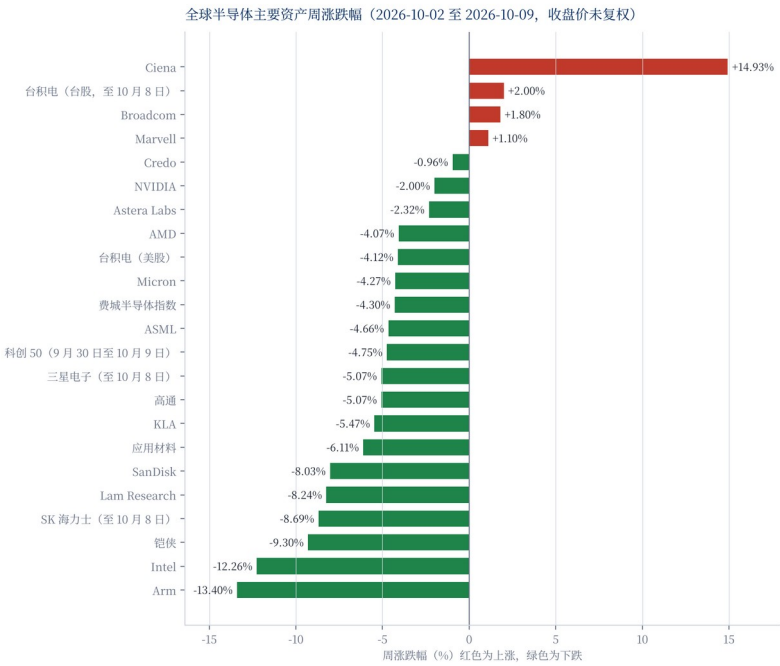


图 1 全球半导体主要资产周涨跌幅 (2026-10-02 至 2026-10-09, 收盘价未复权; 韩台标的截至 10 月 8 日, 科创 50 为 9 月 30 日至 10 月 9 日; 数据来源: stockanalysis.com、investing.com、东方财富)

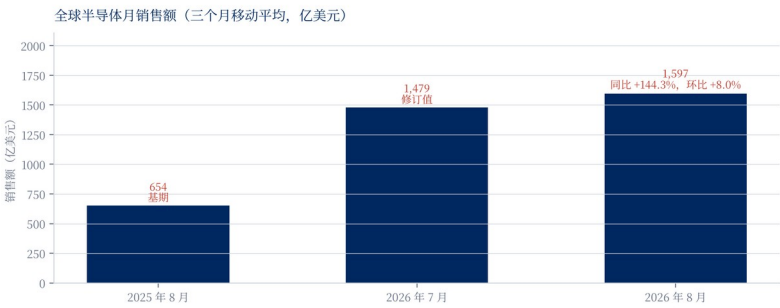


图 2 全球半导体月销售额 (三个月移动平均; 数据来源: SIA, 2026 年 10 月发布)



图 3 韩国 9 月出口结构与主要出口品同比 (数据来源: 韩国官方贸易统计, 经 Yonhap 转载)

一、本周要点

存储与晶圆代工的利润仍在加速，资本市场已开始按价格涨幅收窄与融资成本上升重新定价。

- **三星电子三季度营业利润首次超过 100 万亿韩元。** 初步营业利润 107.4 万亿韩元、同比增长 782.5%，营收 195 万亿韩元、同比增长 126.6%；HBM4 开始向 NVIDIA Vera Rubin 平台实质供货，完整财报 10 月 29 日公布。
- **Micron 第四财季营收 542.3 亿美元，毛利率 87.0%。** 第一财季营收指引 615 亿美元±15 亿美元，中值较第四财季增长 13.4%；毛利率指引约 86.25%，首次低于上一季实际值。
- **存储股在业绩发布周下跌。** SK 海力士跌 8.69%、铠侠跌 9.30%、SanDisk 跌 8.03%、三星电子跌 5.07%、Micron 跌 4.27%；TrendForce 预测四季度常规 DRAM 合约价上涨 10%—15%，涨幅较三季度收窄。
- **台积电三季度营收超出指引上限。** 7—9 月合计 14,942.4 亿新台币、同比增长 50.9%，按公司 32 的汇率假设折约 467 亿美元，高于 458 亿美元的指引上限约 2%。
- **Intel 与 Arm 领跌美股半导体。** Intel 周跌 12.26%、Arm 周跌 13.40%；马斯克 10 月 3 日确认 Terafab 与台积电接触，Intel 此前是唯一公开的制造合作方。
- **AMD 把产能规划提前 3 至 5 年。** MI450 采用台积电 2nm 与 CoWoS，三季度进入生产、2027 年大量出货，MI455 于 2027 年上半年投产。
- **测试成为新的产能约束。** 野村估计 Rubin 平台最终测试时间约为 Hopper 的 7 倍，测试成本占 GPU 制造成本由 1.9% 升至 3.3%；测试厂矽格客户已签订一年以上产能协议。
- **韩国 9 月半导体出口占总出口近一半。** 半导体出口 603 亿美元、同比增长 263%，占总出口 49.9%；台湾 9 月出口 872.2 亿美元、同比增长 60.9%。
- **全球半导体销售 1—8 月累计突破 1 万亿美元。** SIA 公布 8 月销售额 1,597 亿美元、同比增长 144.3%、环比增长 8%，美洲同比增长 180.9%、中国同比增长 131.3%。
- **A 股节后补跌。** 科创 50 节后两个交易日累计下跌 4.75% 至 1,457.27 点，半导体板块 5 日主力资金净流出 442.94 亿元。

二、重大事件及其影响

本周 10 件重大事件中，5 件与存储利润和价格相关，3 件与先进制程和封装测试产能相关。

事件	环节	对产业的影响	来源与可信度
三星电子三季度初步营业利润 107.4 万亿韩元、同比 +782.5%	存储	存储部门营业利润率据券商估计可能超过 80%；HBM4 开始向 NVIDIA 供货，三星在 HBM 的份额差距收窄；关注 10 月 29 日分部数据	公司初步业绩公告，可信度高
Micron 第四财季营收 542.3 亿美元、第一财季指引 615 亿美元	存储	毛利率 87% 说明定价权仍在供给方；毛利率指引首次低于上一季实际值，成本上升开始追上价格	公司新闻稿，可信度高
四季度常规 DRAM 合约价预测 +10%—	存储价格	涨幅收窄，存储股估值依据由涨价幅度转向紧张持续时间；下游成本压力延续但边际放缓	研究机构报告，可信度中高

事件	环节	对产业的影响	来源与可信度
15%、NAND +15%—20%			
台积电三季度营收14,942.4 亿新台币、同比 +50.9%	晶圆代工	高于指引上限约 2%；10 月 15 日四季度指引决定全年增速能否超过 40%	公司月营收公告，可信度高
Terafab 与台积电接触，Intel 周跌 12.26%	晶圆代工	Intel 代工业务唯一公开的大型外部项目面临竞争；台积电美国产能扩张压力上升	企业负责人公开表态，可信度中高
AMD 产能规划提前 3 至 5 年	设计与制造	加速器厂商以长约锁定先进制程与封装，二线客户获取 2nm 与 CoWoS 产能难度上升	公司表态，可信度中高
Rubin 最终测试时间约为 Hopper 的 7 倍	测试	测试厂议价能力上升，测试设备需求增速高于前道设备	券商估计，可信度中高
NVIDIA NVHBM 方案把内存控制器移入 HBM 基础裸片	存储与制造	HBM 基础裸片转向外部先进制程晶圆厂，台积电在 HBM 价值链中的份额上升	行业媒体，可信度中高
JEDEC 发布首个硅光可靠性标准 JESD264	光互连	硅光器件认证流程统一，近封装与共封装光学量产认证周期有望缩短	标准组织发布，可信度高
韩国 9 月半导体出口 603 亿美元、同比 +263%	宏观	韩国出口对存储价格的敏感度达到历史高位	官方统计经通讯社转载，可信度高

三、行业景气与资本市场

8 月全球半导体销售额同比增长 144.3%，景气数据继续加速；但费城半导体指数周跌 4.30%，同期标普 500 ETF 上涨 1.16%，半导体板块在业绩超预期的一周跑输大盘约 5.5 个百分点。

SIA 8 月全球销售额 1,597 亿美元，环比增长 8%，高于 7 月首次公布时的 6.4%；7 月值修订为 1,479 亿美元。各地区环比全部为正，范围在 6.6%（中国）至 9.1%（亚太其他）之间；同比方面，美洲增长 180.9%、亚太其他 143.0%、中国 131.3%、欧洲 98.5%、日本 62.3%。1—8 月累计突破 1 万亿美元，全年超过 1.6 万亿美元的预测将在年底前得到确认。韩国 9 月总出口 1,209 亿美元、同比增长 83.5%，贸易顺差 498.5 亿美元，均为纪录，但汽车出口同比下降 5.5%，增长集中于半导体单一品类。台湾 9 月出口连续第 35 个月增长，电子零组件出口 311.3 亿美元、同比增长 45.3%。

指标	最新值	变化	说明
全球半导体月销售额（8 月）	1,597 亿美元	同比 +144.3%，环比 +8.0%	三个月移动平均；1—8 月累计突破 1 万亿美元
日本制半导体设备销售额（8 月）	5,979 亿日元	同比 +47.4%	连续第六个月加速；9 月数据 10 月下旬发布
韩国半导体出口（9 月）	603 亿美元	同比 +263%	占总出口 49.9%

指标	最新值	变化	说明
台湾出口（9月）	872.2 亿美元	同比 +60.9%	10 月预计 852 亿—877 亿美元
台积电营收（9月）	5,118.6 亿新台币	环比 -0.6%，同比 +54.6%	1—9 月累计同比 +41.1%
鸿海营收（9月）	1.159 万亿新台币	同比 +38.42%	首次单月突破 1 万亿新台币
费城半导体指数（10 月 9 日）	12,572.4	周 -4.30%	距 6 月 22 日峰值回撤 14.1%
科创 50 指数（10 月 9 日）	1,457.27	节后两日 -4.75%	较 9 月 18 日回落 11.8%
美债 10 年期收益率（10 月 9 日）	5.24%	周 -4 个基点	9 月初约 4.75%

标的	10 月 2 日	10 月 9 日	周涨跌	说明
Ciena	391.34	449.77	+14.93%	光通信设备，本周涨幅最大
Broadcom	355.14	361.54	+1.80%	定制芯片
Marvell	272.29	275.28	+1.10%	定制芯片与光互连
NVIDIA	233.95	229.28	-2.00%	NVHBM 方案
AMD	633.91	608.10	-4.07%	产能规划提前 3 至 5 年
台积电（美股）	472.78	453.31	-4.12%	三季度营收超指引
Micron	1,074.89	1,029.00	-4.27%	第一财季指引 615 亿美元
ASML	1,867.31	1,780.34	-4.66%	三季度财报 10 月中旬
应用材料	540.04	507.03	-6.11%	设备
SanDisk	1,719.99	1,581.82	-8.03%	NAND 晶圆现货周跌 2.90%
Lam Research	347.49	318.84	-8.24%	设备股跌幅最大
Intel	119.33	104.70	-12.26%	Terafab 合作方之争
Arm	307.49	266.28	-13.40%	本周跌幅最大

资本市场的分化有三层。第一层是存储：Micron、SanDisk、SK 海力士、铠侠在业绩超预期后下跌 4%—9%，市场按四季度合约价涨幅收窄定价。第二层是代工合作关系：Intel 与 Arm 一周合计下跌超过 25 个百分点。第三层是设备：Lam Research 跌 8.24%、应用材料跌 6.11%、KLA 跌 5.47%，与日本设备销售连续加速的数据方向相反。本周上涨的只有 Broadcom（+1.80%）、Marvell（+1.10%）与 Ciena（+14.93%），均与定制芯片或光互连相关。宏观层面，美债 10 年期收益率较 9 月初抬升约 50 个基点，布伦特原油重回每桶 100 美元上方，数据中心建设的资金与能源成本同步上升。

四、存储周期与装备制造链

存储利润达到历史高点而价格涨幅收窄，设备订单数据向上而设备股连续第四周与数据背离。

三星电子三季度营业利润 107.4 万亿韩元，券商估计存储部门营业利润率可能超过 80%；Micron 第四财季毛利率 87.0%，2026 财年营收 1,331.9 亿美元；南亚科三季度营收 1,336.5 亿新台币、环比增长 61.9%，9 月营收同比增长 576.62%。三家公司的营收与利润增速均为各自历史最高。价格方面，TrendForce 预测四季度常规 DRAM 合约价环比上涨 10%—15%、NAND 上涨 15%—20%；南亚科预计四季度平均售价上涨约 10%，只能满足客户 50%—60% 的需求。现货横盘：DDR5 16Gb 现货 10 月 9 日报 58.900 美元，较 9 月 21 日上涨 3.5%；DDR4 16Gb 报 83.640 美元、下降 1.6%，新旧制程价格倒挂由 28.1 美元收窄至 24.7 美元；512Gb TLC NAND 晶圆现货周跌 2.90% 至 18.833 美元。供给紧张延续至 2027 年：Micron 2027 年大部分 HBM 供应已签约且价格高于 2026 年，韩国券商估计 2027 年 HBM 售价可能同比翻倍以上。存储利润增速将在 2026 年四季度至 2027 年一季度见顶，但下游的存储成本压力在 2027 年上半年仍会上升。

HBM 的结构也在变化。NVIDIA NVHBM 方案把内存控制器移入 HBM 基础裸片，带宽较标准 HBM4E 最高提升 30%、功耗最高降低 15%；Micron HBM4E 基础裸片转由外部晶圆厂制造，SK 海力士 HBM4 基础裸片采用台积电 12nm、HBM4E 优先 3nm。HBM 的价值由存储厂独享转为存储厂与晶圆厂分享。

测试环节是本周新增的约束。野村估计 Blackwell 的最终测试时间约为 Hopper 的 4 倍、Rubin 约为 7 倍，GPU 制造成本中测试占比由 Hopper 的 1.9% 升至 Blackwell 的 2.5%、Rubin 的 3.3%；台湾测试厂矽格月营收连续 3 个月超过 20 亿新台币，2026 年资本开支增至 88 亿新台币、同比增长 48%。测试环节的价值增量来自芯片复杂度上升而非单纯产量增长，2027 年测试设备与测试服务的增速将高于晶圆制造。光互连方面，JEDEC 发布首个硅光可靠性标准，台积电 COUPE 200Gbps 微环调制器计划年底量产，华为主推近封装光学，TrendForce 预计 2031 年 VCSEL 近封装光学需求达 6.5 亿颗。

设备方面，日本制设备 8 月销售 5,979 亿日元、同比增长 47.4%，Micron 2027 财年上半年资本开支约 250 亿美元，台积电 2026 年资本开支区间 600 亿—640 亿美元，测试厂矽格资本开支增长 48%，SK 海力士 2026 年 HBM4 晶圆测试机订单合计 2,839.4 亿韩元。需求侧没有下调的公开信息，但设备股本周普遍下跌 5%—8%，市场把存储涨幅收窄解读为 2027 年存储资本开支增速放缓的先行指标。10 月 13 日至 15 日 SEMICON West 与 10 月中下旬设备企业财报将给出 2027 年订单口径；若主要设备企业表示 2027 年持平，设备股回撤反映的是真实预期而非估值调整。

五、政策、贸易与供应链安全

本周美国没有新的半导体出口管制规则与实体名单增列，规则层面连续第三周空窗；11 月上旬两项贸易限制措施的暂停期到期，是四季度政策风险最集中的时点。

10月5日至11日美国联邦公报中含半导体字样的文件共3件，分别为氢氟碳化物2027年配额分配、Ultra Clean Technology 得州 Manor 自贸区生产授权，以及一项 DRAM 器件专利纠纷因当事方和解终结，均不涉及出口限制；半导体关税第二阶段的税率与生效日仍未公布，美方此前表示在美建厂的企业将获豁免。美国对实体名单企业持股 50% 以上子公司一并适用限制的规则（关联方规则）暂停期将于 11 月 9 日至 10 日到期，本周未见延期公告；先进制造投资税收抵免对 2026 年 12 月 31 日之后开工的项目失效，四季度美国晶圆厂开工公告可能集中。

中美经贸磋商后，双方各公布约 300 亿美元非敏感商品降税清单，芯片、电动车与电池不在清单内，半导体关税与出口限制不随本轮降税调整。中方 2025 年 10 月出台的稀土与相关技术出口限制措施暂停期至 2026 年 11 月 10 日，对美镓、锗、铋出口限制暂停期至 11 月 27 日，本周均无延期公告。欧盟芯片法案 2.0 仍在立法程序中；日本为 Rapidus 提出 2027 财年约 1,500 亿日元的预算申请，Rapidus 目标 2027 财年量产；韩国首个对美投资项目为得州燃气联合循环电站，造价 223 亿美元，不属于半导体项目。企业四季度的海外采购、境外子公司持股与出口许可安排，应分别按"暂停期延长"与"措施恢复"两种情形准备。

六、重点企业动态

三星电子、Micron、台积电公布了超预期数字，Intel 与 Arm 因 Terafab 合作方之争领跌。

企业	本周动态	关键数字	市场反应
三星电子	三季度初步业绩；HBM4 向 NVIDIA Vera Rubin 供货	营业利润 107.4 万亿韩元	-5.07%（至 10 月 8 日）
SK 海力士	HBM4 基础裸片采用台积电 12nm；HBM4 晶圆测试机订单	2,839.4 亿韩元	-8.69%（至 10 月 8 日）
Micron	第四财季业绩；2027 财年上半年资本开支约 250 亿美元	营收 542.3 亿美元	-4.27%
台积电	9 月与三季度营收；与 Terafab 接触	三季度 14,942.4 亿新台币	美股 -4.12%
NVIDIA	NVHBM 方案	带宽最高 +30%	-2.00%
AMD	首席执行官访台；MI450 三季度进入生产	在台投资超过 100 亿美元	-4.07%
Intel	首席执行官称仍是 Terafab 开发伙伴	10 月 5 日盘中最低 114.33 美元	-12.26%
南亚科	三季度营收；四季度售价预计 +10%	1,336.5 亿新台币	—

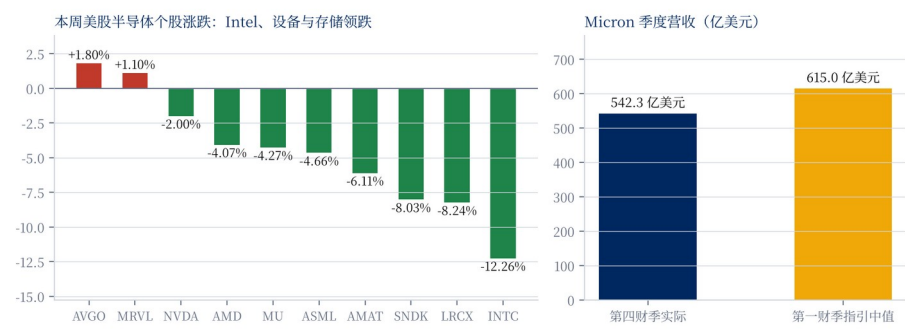


图 4 本周美股半导体个股涨跌与 Micron 季度营收（数据来源：stockanalysis.com、Micron 新闻稿）

台积电方面，9 月营收 5,118.6 亿新台币，环比下降 0.6%，三季度合计环比增长 17.6%，正式财报 10 月 15 日发布；摩根大通预期四季度营收环比增长约 11%。AMD 首席执行官 10 月 6 日访问台积电及供应链伙伴，公司表示产能规划已提前 3 至 5 年，加速器龙头以多年合约锁定先进制程与封装后，可供新进入者的 2nm 与 CoWoS 产能比例下降。Intel 首席执行官 10 月 7 日表示 Intel 仍是 Terafab 开发伙伴，Terafab 的最终制造分工尚未确定。鸿海 9 月营收首次单月突破 1 万亿新台币，人工智能服务器组装在三季度末集中出货。

七、中国半导体产业链

A 股节后两个交易日科创 50 下跌 4.75%，粤芯半导体以 12.01 元发行、募资约 61.57 亿元；本周中国产业链可核实的一手公告较少。

加速器方面，华为副董事长徐直军 10 月 7 日表示昇腾在中国市场的份额可能已超过 NVIDIA，昇腾 950DT 超节点预计 2026 年底至 2027 年初放量，Hi-ONE 近封装光学模块达到 7.2T；TrendForce 预计 2026 年国产芯片占中国高端人工智能芯片近 90%。海光信息 9 月 22 日发布 1000 系列嵌入式处理器，首次进入工业控制领域，未公布性能参数与量产时点。晶圆制造方面，粤芯半导体（创业板 301660）发行价 12.01 元，网上有效申购倍数 2,359.68 倍，未行使超额配售权时募资约 61.57 亿元，低于拟募的 75 亿元，10 月 13 日上市。设备方面，成都双流首批国产微米级接近式光刻机订单突破 1 亿元，面向光芯片、显示与 LED，属特色工艺设备，与集成电路先进制程光刻不属同一技术层面。

领域	本周事实	影响	可信度
加速器	昇腾 950DT 超节点 2026 年底至 2027 年初放量；国产芯片预计占中国高端人工智能芯片近 90%	国产加速器在国内高端市场占比继续上升	企业表述与研究机构预测，中
嵌入式处理器	海光 1000 系列面向工业控制	国产处理器产品线向端侧扩展	发布会报道，高
晶圆制造	粤芯半导体发行价 12.01 元，募资约 61.57 亿元	特色工艺晶圆厂融资渠道仍然畅通	发行公告，高
设备	国产接近式光刻机订单超过 1 亿元	特色工艺设备国产化	单一媒体，中
资本市场	科创 50 节后两日 -4.75%；半导体板块 5 日净流出 442.94 亿元	节后资金流出，与美股半导体同向	行情数据，高

资本市场方面，10月8日A股复市，科创50下跌4.82%、创业板指下跌3.15%，成交1.69万亿元；10月9日指数深V收红，科创50收1,457.27点、上涨0.07%，成交约1.9万亿元。半导体板块10月9日下跌0.68%，182只成分股中36只上涨，5日主力资金净流出442.94亿元、20日净流出630.07亿元。科创50较9月18日累计回落11.8%。计划在四季度融资的半导体企业，首发定价需较三季度更为保守。

八、行业会议与人物观点

本周没有重要的半导体行业会议；10月12日至15日OCP全球峰会与10月13日至15日SEMICON West同期举行，是数据中心供电与设备资本开支口径的集中发布窗口。

OCP全球峰会在加州圣何塞举行，关注800V高压直流供电与液冷规范，以及近封装与共封装光学的供应商名单；SEMICON West 2026在旧金山Moscone Center举行，为最后一届秋季档，2027年起改为春季举办。10月15日台积电三季度财报说明会将给出四季度指引、2027年资本开支与CoWoS产能目标。ICCAD-Expo 2026于11月19日至20日在北京举行。本周JEDEC发布首个硅光可靠性标准JESD264，覆盖硅光裸片与芯片组可靠性、元件认证、装配与激光集成、制程控制与追溯四个领域。

企业与机构观点方面：马斯克10月3日称Terafab与台积电“只是讨论，但可能有结果”；南亚科管理层表示四季度只能满足客户50%—60%的DRAM需求；矽格管理层表示客户已签订一年以上产能协议并接受涨价。野村估计GPU制造成本中测试占比由Hopper的1.9%升至Rubin的3.3%；KB证券估计2027年HBM售价可能同比翻倍以上，HBM4将占2027年HBM营收80%；摩根士丹利估计到2028年人工智能基础设施需要1.5万亿美元外部融资；TrendForce预计2027年全球笔记本电脑出货低个位数下滑，主要风险由供给紧张转为成本上升压制需求。

九、趋势判断

本期给出7条判断，核心是存储利润增速将在2026年四季度至2027年一季度见顶，先进制程、先进封装与测试的紧张延续至2027年。

- **存储利润增速在2026年四季度至2027年一季度见顶。** 前提条件：四季度DRAM合约价涨幅10%—15%兑现，2027年一季度首批报价涨幅低于四季度。反向情形：若2027年一季度报价涨幅高于15%，见顶时点推迟至2027年二季度以后。
- **HBM紧张延续至2027年底。** 前提条件：2027年大部分HBM已签约、HBM4E在2027年量产。反向情形：若三星HBM4在2026年四季度获得第二家主要客户认证，2027年下半年紧张程度缓解。
- **台积电2026年营收增速超过40%。** 前提条件：四季度营收环比增长10%左右。反向情形：若10月15日四季度指引环比增长低于5%，下调至35%—40%。
- **测试在2027年成为与先进封装同级的瓶颈。** 前提条件：Rubin平台2027年放量。反向情形：若测试厂四季度涨价幅度低于5%，维持封装为第一瓶颈的判断。

- **人工智能基础设施的外部融资在 2027 年上半年继续扩大。** 前提条件：10 年期美债收益率维持在 5.5% 以下。反向情形：若收益率升破 5.5%，下调 2027 年非云厂商采购预期。
- **设备股与订单数据的背离在 10 月下旬前后结束。** 前提条件：设备企业在 SEMICON West 与三季度财报中给出 2027 年增长口径。反向情形：若主要设备企业表示 2027 年持平，设备股回撤延续。
- **11 月上旬贸易限制措施的暂停期到期是四季度主要政策变量。** 前提条件：关税休战已延至 2027 年 1 月。反向情形：若两项暂停期均未延长，四季度政策风险判断上调为已兑现。

十、主要风险与下周关注事项

主要风险集中在存储涨幅收窄、融资成本上升与 11 月上旬政策节点三个方面。

风险	发生条件	影响
存储涨幅加速收窄	2027 年一季度 DRAM 合约价预测低于 5%	存储股与设备股回撤延续，2027 年存储资本开支下调
利率与融资成本	10 年期美债升破 5.5%	依赖债务融资的加速器采购规模下调
贸易限制措施恢复	11 月上旬两项暂停期未延长	对华出口合规范围扩大；设备与材料企业稀土相关成本上升
代工合作伙伴变化	Terafab 确定由台积电承担主要制造	Intel 代工外部客户收入预期下调
下游需求	2027 年消费电子出货下滑超过 5%	常规 DRAM 与 NAND 需求下降，价格提前回落

日期	事件	关注要点	需要修正本期判断的情形
10 月 12—15 日	OCP 全球峰会	800V 高压直流与液冷规范	若 800V 规范未发布，数据中心供电约束缓解的判断推迟
10 月 13 日	粤芯半导体创业板上市	首日表现	若首日破发，特色工艺晶圆厂融资窗口判断下调
10 月 13—15 日	SEMICON West 2026	设备企业 2027 年至 2028 年资本开支口径	若主要设备企业表示 2027 年持平，设备需求判断下调
10 月 15 日	台积电三季度财报	四季度营收与毛利率指引、CoWoS 产能	若四季度营收指引环比低于 5%，全年增速判断下调
10 月中旬	ASML 三季度财报	新增订单与存储客户占比	若新增订单环比下降超过 20%，设备判断下调
10 月下旬	日本 9 月设备销售	同比能否高于 47.4%	若同比低于 35%，设备需求加速判断修正
10 月 29 日	三星电子完整财报	存储部门营业利润率	若低于 75%，利润见顶时点提前
11 月上旬	两项贸易限制措施暂停期到期	延长或恢复安排	若均恢复，四季度政策风险判断上调为已兑现

十一、管理观察与行动建议

存储涨幅收窄但供给仍紧，先进产能被长约锁定，融资成本上升，企业应在四季度完成 2027 年产能与成本的锁定安排。

芯片设计与系统企业：AMD 已把产能规划提前 3 至 5 年，计划在 2027 年至 2028 年采用 2nm 或 CoWoS 的二线设计企业，应在四季度内与代工厂确定产能份额；存储涨幅收窄并不等于成本下降，2027 年产品定价应按一季度存储合约价再上涨 5%—10% 测算。

制造、存储与封测企业：Micron 毛利率指引首次低于上一季实际值，存储企业在四季度长期供货合同谈判中应把重点由价格转向期限与数量；测试时间延长为测试厂提供定价能力，封测企业可参照一年以上产能协议的方式与加速器客户签订产能预留安排。

设备与材料企业：设备股回撤与订单数据背离，设备企业应在 SEMICON West 与三季度财报中公开 2027 年订单的客户结构与存储、逻辑占比；测试设备与 HBM 晶圆测试机需求增速高于前道设备，相关产品的产能扩张可以提前。

中国产业链企业：11 月上旬两项贸易限制措施暂停期到期，企业应在 10 月底前分别按延长与恢复两种情形准备海外采购与境外持股方案；节后半导体板块资金持续流出，计划在四季度融资的企业宜优先考虑发行周期较短的工具，首发定价需保守。

政策研究者：本轮中美非敏感商品降税清单不包括芯片，半导体关税与出口限制应视为独立于一般贸易磋商的议题；人工智能基础设施的外部融资规模扩大，私募信贷与芯片供应商参与客户融资的做法值得在金融稳定层面跟踪。

上市公司与资本市场研究者：存储股的估值依据由价格涨幅转为紧张持续时间，研究模型应把 2027 年 HBM 签约比例与常规 DRAM 季度涨幅分开建模；Intel 与 Arm 一周合计下跌超过 25 个百分点，代工合作关系的单一事件对估值的影响已超过季度业绩。

数据来源与口径

本报告涨跌幅统一为 2026 年 10 月 2 日收盘至 10 月 9 日收盘，未复权，不作汇率换算；韩国与台湾市场 10 月 9 日休市，相关标的取 10 月 8 日收盘；A 股 10 月 1 日至 7 日休市，科创 50 以 9 月 30 日为基期。全球销售数据为 SIA 发布的三个月移动平均口径；台积电三季度美元金额按 1 美元兑 32 新台币折算，官方美元口径以 10 月 15 日财报为准；费城半导体指数年内涨幅为估算值。主要来源包括 SIA、SEMI、日本半导体制造装置协会、各公司业绩公告与新闻稿、TrendForce、DRAMeXchange、美国联邦公报、stockanalysis.com、investing.com 与主要财经媒体。单一来源且未获当事方确认的信息未进入本报告的判断。

本报告由百思特变革研究院半导体智库基于公开信息编制，数据截至 2026-10-12。报告内容仅供行业研究参考，不构成任何投资建议，不代表任何政府机构或监管部门的立场；所涉政策信息均来自公开发布的法规、公告与新闻报道；引用请注明出处。